

閎康科技

智慧財產報告書

MA·tek

TITLE OF CONTENTS

▶ 公司 / 組織概況

基本資料與組織簡介	02	企業經營模式	09
企業整體組織	09	企業未來願景	10

▶ 核心技術分析

企業核心技術說明	10	企業核心技術及其衍生產品之競爭優勢分析	11
----------------	----	---------------------------	----

▶ 研發策略與資源

研發策略與方向	15	企業研發資源與能力	15
---------------	----	-----------------	----

▶ 智財策略管理與成果應用

智財策略與目標	17	用途與貢獻	24
智財管理制度 / 實施方式	18	風險應對措施	25
智財清單 / 智財成果	20		

基本資料與組織簡介

公司 / 組織概況

基本資料

閱康科技股份有限公司(下稱:閱康科技)由謝詠芬博士於2002年於新竹縣竹北市設立,實收資本額為新台幣6.23億元,營業內容係屬半導體相關之材料、化學和故障分析之知識經濟產業,在2002年成立之初,即獲得經濟部工業局專函核准得提供研發服務和智慧財產權服務。謝詠芬董事長為材料博士,擁有30年以上相關經歷,歷任工研院電子所工程師、美國貝爾實驗室(Bell Labs) 博士後研究員、聯電品質暨可靠度保證部資深經理,歷練產業別包括:IC(Si)、TFT-LCD、LED(III-V, II-VI)、LCOS、GaAs、Ge/ Metal contacts system。

閱康科技為具備完整材料分析、故障分析及可靠度測試的獨立專業實驗室,主要提供積體電路、平面顯示器、光電產業、測試封裝、奈米元件材料等高科技產業之上、中、下游材料及電子元件廠商所需之產品研發、製造與品質管理分析服務,詳細基本資料如表1-1所示。

表1-1:閱康科技基本資料

公司名稱	閱康科技股份有限公司
行業別	其他電子業
實收資本額	新台幣 6.7 億元
營業額	新台幣 51.1 億元 (2024年)
負責人	謝詠芬
總公司地址	新竹市東區力行一路一號1A3
公司設立日	2002.05.14
員工人數	1500人(全球)



閱康科技為貼近服務客戶，目前於台灣 (新竹科學園區矽導實驗室、展業實驗室、金山實驗室、竹北台元科技園區、台南南科實驗室)、上海 (張江高科技園區、金橋工業園區)、廈門 (高新技術產業開發區)、深圳(甲岸科技園區)及日本名古屋、熊本、北海道等地設置服務據點(圖 1-1)，詳細關係企業組織圖如下(圖 1-2) 所示。

組織簡介

閱康科技於 2009 年在台灣掛牌上櫃 (3587, TW)，以技術及成本優勢，進攻歐、美、日、及大陸市場，為全球相關產業各知名大廠提供檢測分析服務，並成為全球頂尖第三方獨立專業分析實驗室。閱康科技在材料分析領域已成為國際領導廠商之一，逐漸取得國際級半導體廠商之訂單，目前客戶分佈在全世界各地，包含台灣、中國、美國、日本、新加坡、馬來西亞等地區，業務亦拓展至歐洲地區，海外比重正快速增加中。台積電、日月光、日立先端、華為至歐美大廠 Nvidia、Qualcomm、Apple、Broadcomm、intel 等，皆為公司重要客戶(圖1-3)。



圖1-1：服務據點

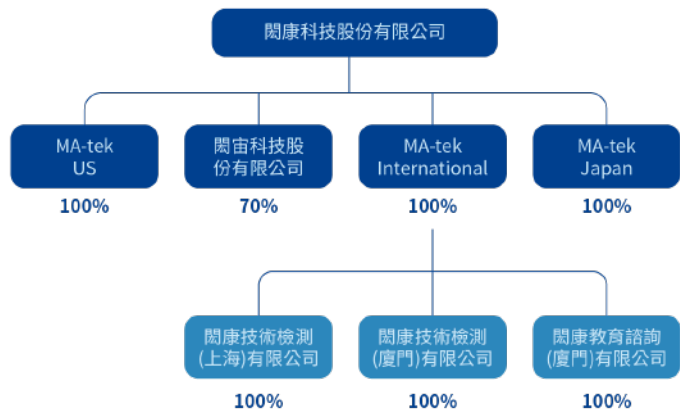


圖1-2：關係企業組織圖 (出資比例)



圖1-3：全球客戶群

閱康科技的營收逐年成長，2024 年營業額達 51.1 億元，成立至今之年複合成長率高達17%(圖1-4)。

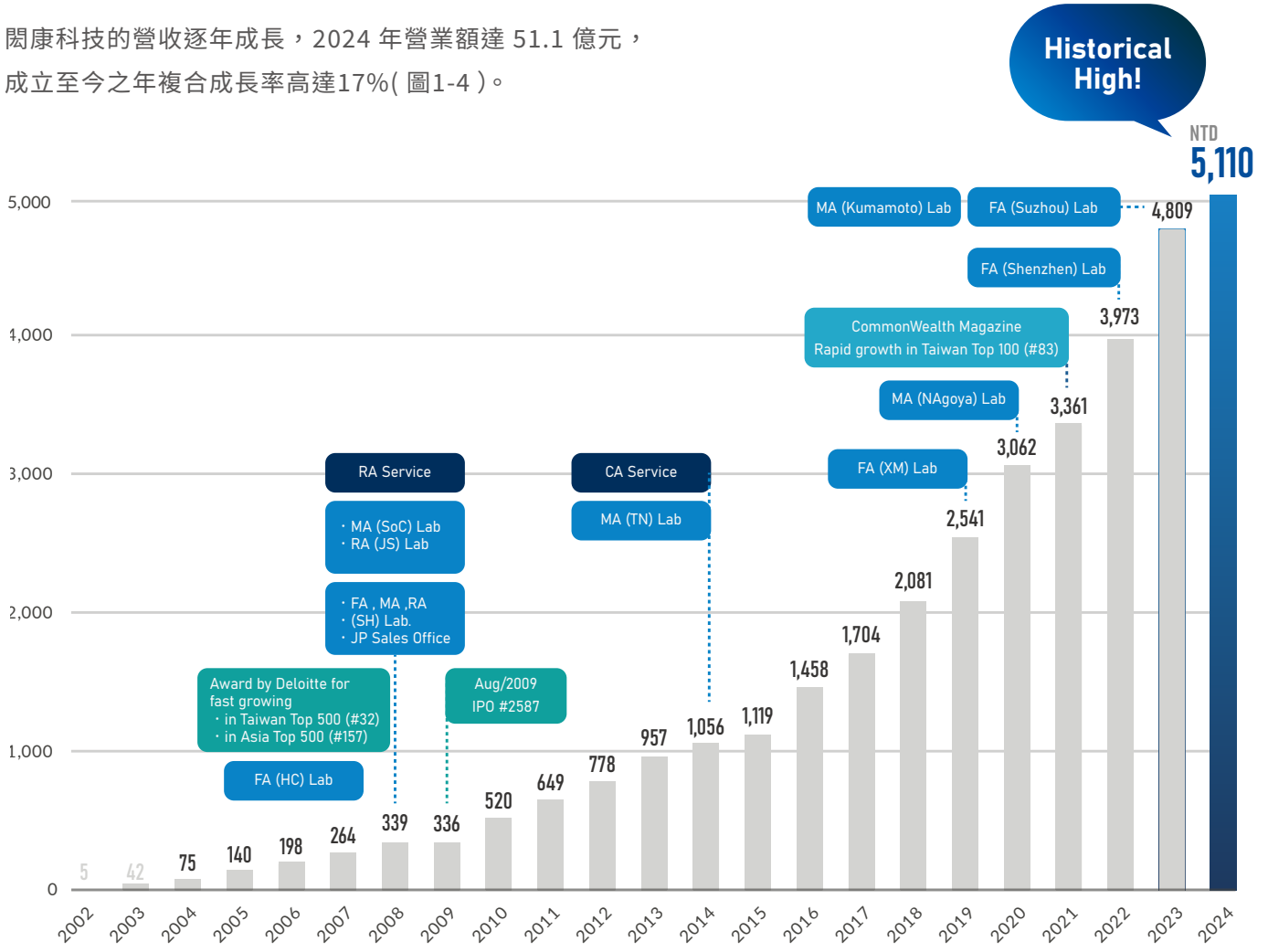


圖1-4：里程碑與年度成長

經營理念

閱康科技永續經營和長期發展的營運架構在四個理念上，期許有科學園區的地方就有閱康科技，針對四個理念的詳細說明如圖1-5所示。



- 高科技產業最頂尖的貴儀中心
First Tier Laboratory in High Tech Industry
- 高科技園區最必要的功能單位
Mandatory Functional Unit in Industry Parks
- 高科技產品最重要的醫學中心
Advanced Medical Center for Electronic Products
- 半導體、電子、金屬、陶瓷、高分子、奈米材料
各產業共同的研發技術平台 & 品質保證實驗室
First Tier Laboratory in High Tech Industry

圖1-5：閱康社會定位



高科技產業的貴儀中心

...

2008年1月，閎康科技於新竹科學園區成立矽導實驗室，除將過去所屬材料分析機台集中管理提供技術服務外，並持續投資先進分析設備。目前閎康科技已然成為國際科技業的貴儀中心，服務的客戶國內各類產業領廠商外，更提供材料分析技術服務給歐、美、日等先進開地區；客戶群涵蓋半導體、汽廠、學術研究單位及設備製造商。閎康科技，是全球的專業策略夥伴和互補實驗室。



高科技產品的醫學中心

...

閎康科技的分析檢測系統如人體的醫療體系一樣，從理科檢查、內科診療、外科手術、到醫學中心的病理研究；對失效樣品，進行非破壞性檢測、電性分析、物性分析到材料分析。藉由相同的診斷邏輯進行詢、分析、修補，提供客戶醫療級的分析檢測服務，成為科技界的高品質醫學中心。



高科技園區的必要功能單位

...

閎康科技扮演產業界的研服務中心，主要業務在於供應鏈上 IC 設計、製造、封裝、測試等各階段所需的分析服務。為了能夠與客戶緊密結合、更貼近客戶提升服務，閎康科技陸續在竹北台元科技園區、新竹科學園區、南科學園區、上海張江高科技園區、廈門湖里區紮根，並於 2011 年進軍日本名古屋成立材料分析實驗室。在科技產業的未來發展上，閎康科技帶給客戶親切，標準化與效率化的高品質分析服務。



各產業共同的技術研發平台

...

在 2002 年成立之初，閎康即獲得經濟部工業局專函核准得提供研發服務和智慧財產權服務，並通過 ANSI/ESD S20.20、ISO9001 (管理)、ISO27001 (資訊安全)、IECQ17025 (Lab Ac-creditation)、TUV Nord Recognition (車用)、ISO15408 (IT Security Evaluation)、台灣智慧財產管理制度 TIPS A 級驗證，以及國際大廠客戶的現場稽核。本公司顯微尺寸量測結果為少數可回溯至美國國家標準研究院 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 驗證的量測標準片之獨立實驗室，可以為客戶提供國際級高品質認證的精確分析數據，是半導體、高分子、電子、金屬、陶瓷、奈米材料等各產業共同的技术研發平台及品質保證實驗室。

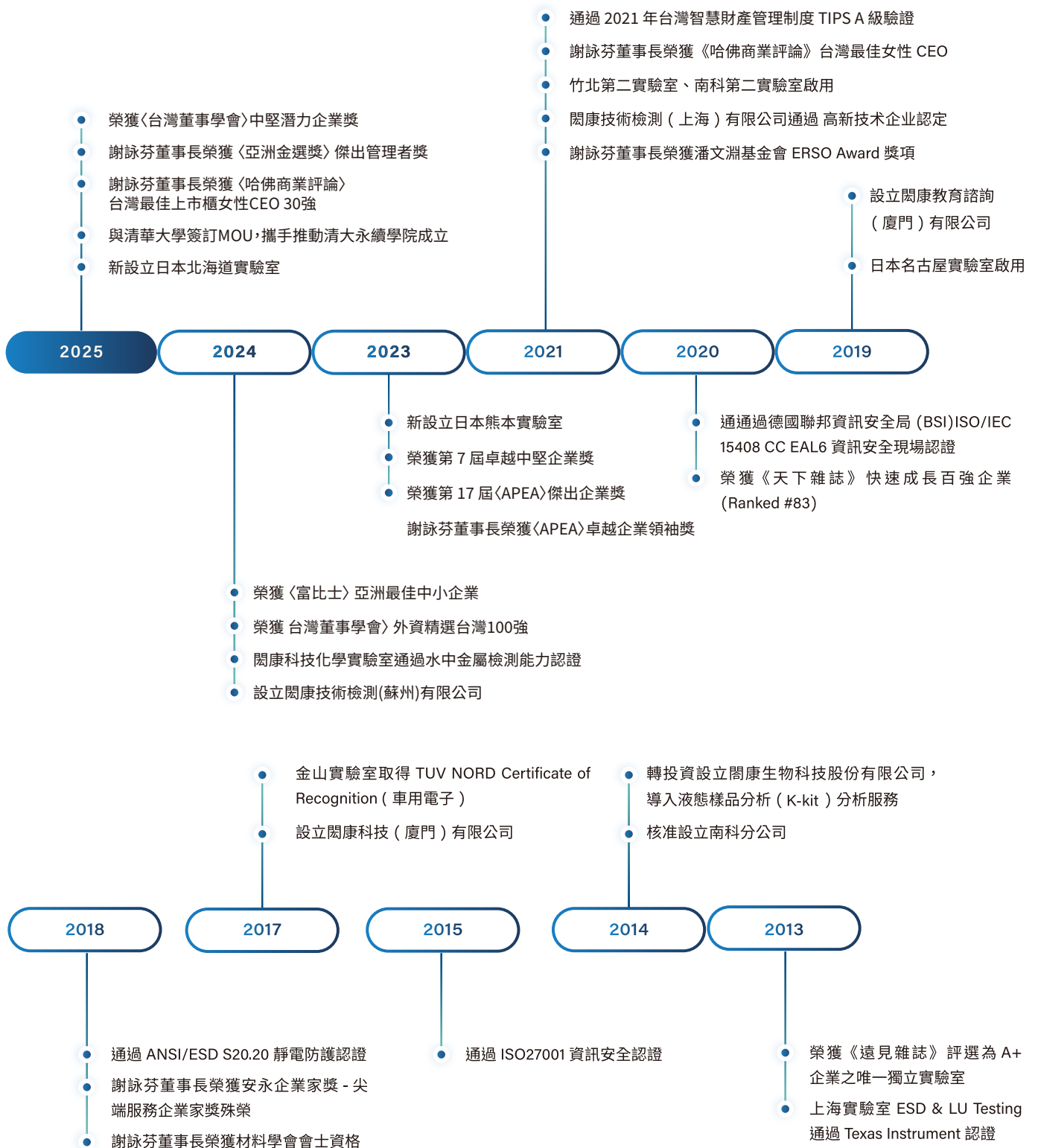
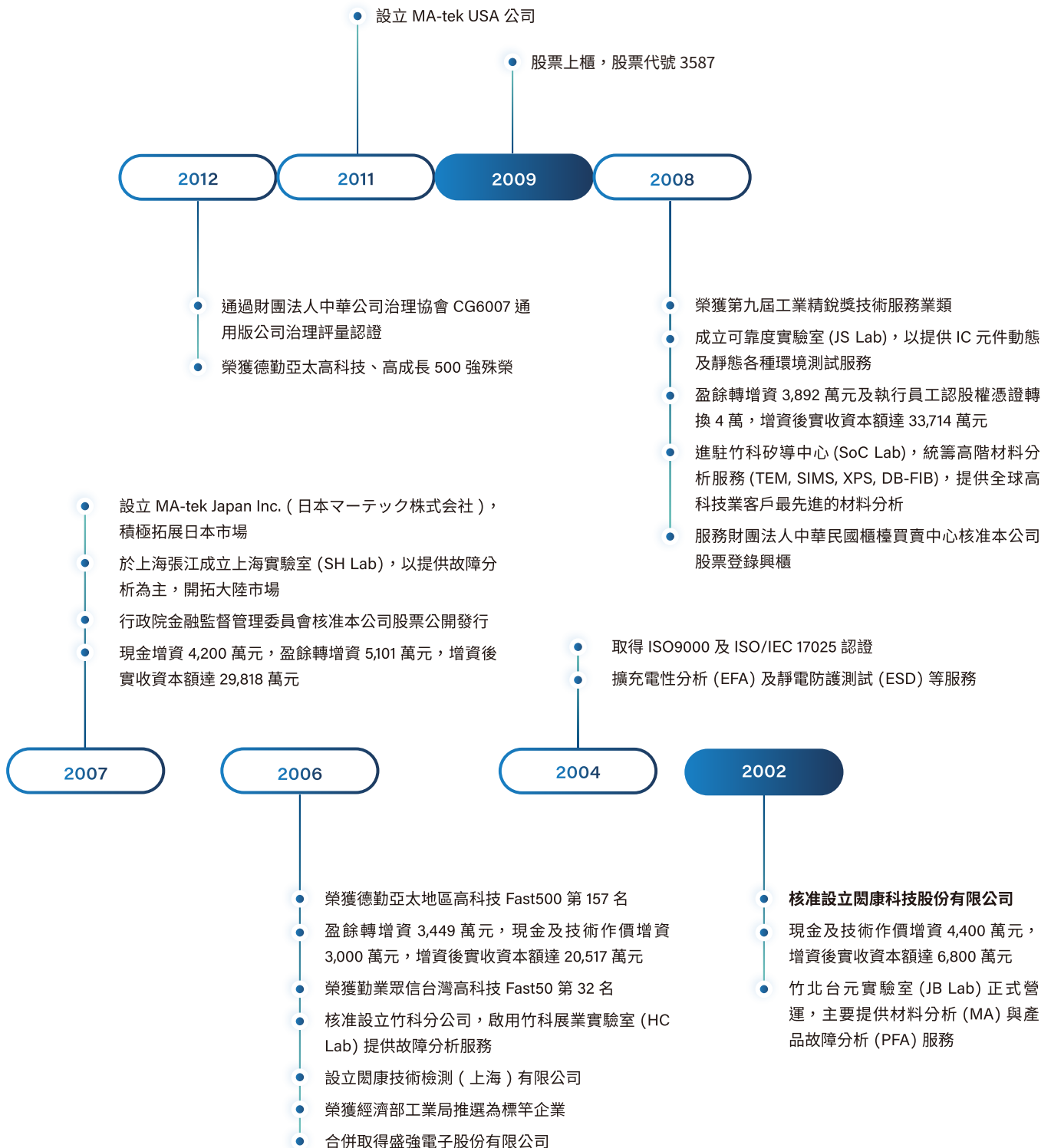


表1-2：發展里程碑



主要營業項目 / 主要產品 / 研發方向

閱康科技是涵蓋電子、電機、材料分析實驗室為內涵的技術服務公司。其核心技術在於將稀有的貴重儀器操作服務，結合顧問與諮詢的功能，準確、正確地提供各種試片製備服務，滿足客戶在研發電子產品和開發新材料結構、新製程時的分析需求，將傳統耗時費力的實驗研究手段，有效地轉化為標準的商業化服務；並導入製造業生產管理手法，以簡易的品質管理指標，承諾客戶合理的成功率和交期。目前每月分析服務件數超過 2000 件，多數服務項目的交期都在 24 小時以內。

閱康科技分析服務的主要業務包括材料分析(Materials Analysis, MA)、故障分析 (Failure Analysis, FA)、可靠度分析 (Reliability Analysis, RA) 及化學分析 (Chemical Analysis, CA) 等，其可完整提供包括積體電路、測試封裝業、光電產業、平面顯示器業、奈米元件材料等高科技產業的上、中、下游的廠商 (圖1-6)，如台積電、聯電、高通、NVIDIA、博通等廠商於產品開發及生產製造所需之分析檢測服務。

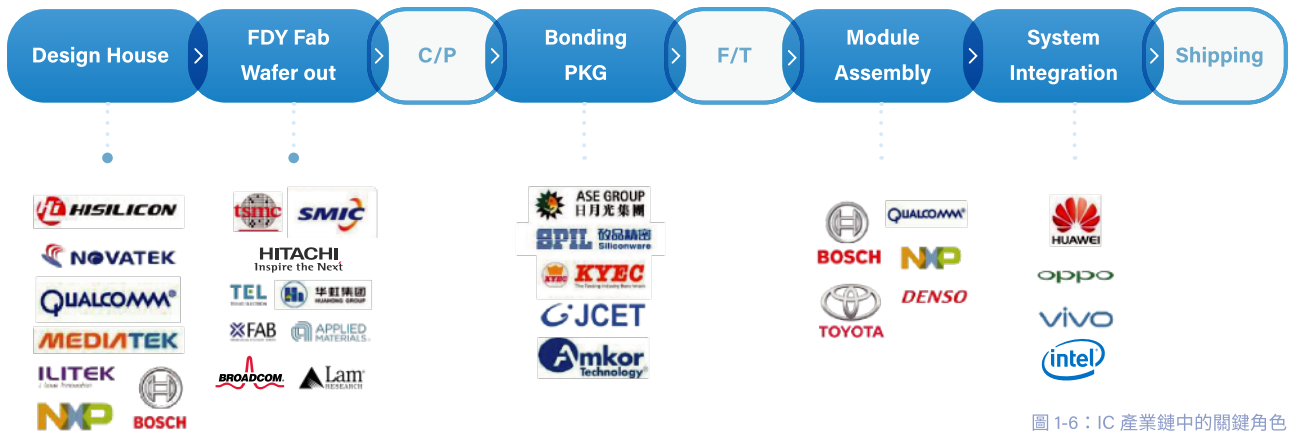


圖 1-6：IC 產業鏈中的關鍵角色

企業特色簡介與獎項

閱康科技擁有全球最完備的材料分析實驗室，全面性提供高科技相關產業各項檢測及分析服務。善盡企業社會責任，關懷員工、重視以人才為本之企業文化；致力環境永續與能源節約，參與社會慈善公益，經營管理亦獲得各界的肯定，歷年來企業屢獲獎項，重要獎項如下。

第九屆工業精銳獎
技術服務業類

IDB 經濟部工業局

2012

Top 500 (#157) rapid growth companies in Asia 2006/2012
Deloitte 勤業眾信

A+ company in Taiwan

Global Views Monthly Magazine 遠見雜誌

2013

中堅潛力企業獎
Mittelstand Potential Award

台灣董事學會
企業發展研究中心

2024

Forbes Asia 200 Best under a Billion
Forbes Asia 富比世

7 th Taiwan Mittelstand Award
MOEA 經濟部

2025

圖 1-7：閱康科技獲獎實績

2 · 企業整體組織

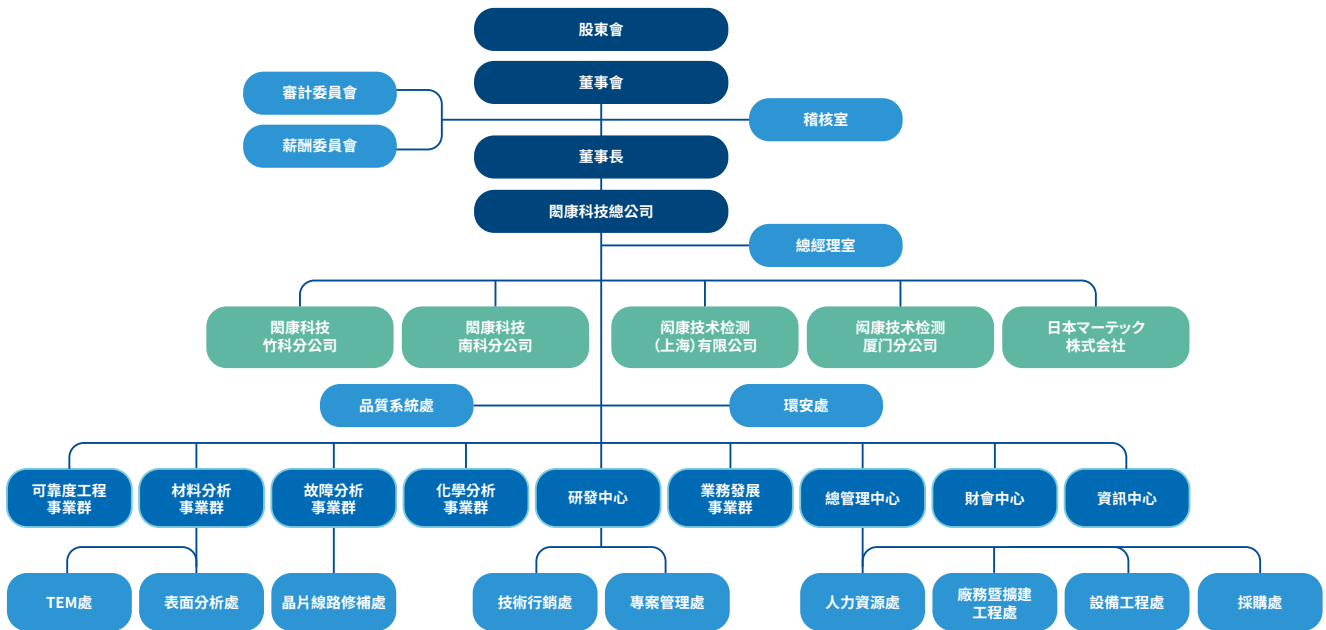


圖 1-8：閩康科技整體組織圖

3 · 企業經營模式

閩康科技係專為半導體上中下游產業供應鏈提供迅速並有效的半導體相關檢測分析服務，在供應鏈中游晶圓代工廠(Foundry Fab)之晶圓產出(Wafer Out)後、在供應鏈下游封裝測試廠(Outsourced Semiconductor Assembly Testing)之後段測試(Final Test)後或甚至到系統廠(System House)組裝後之測試，提供各種可靠度分析(Reliability Analysis)、故障分析(Failure Analysis)及材料分析(Materials Analysis)等服務，協助半導體上中下游產業供應鏈各廠商迅速完成產品定案、修正生產參數、提升產品良率、提供後續產品設計修正改進的建議，如下圖所示。

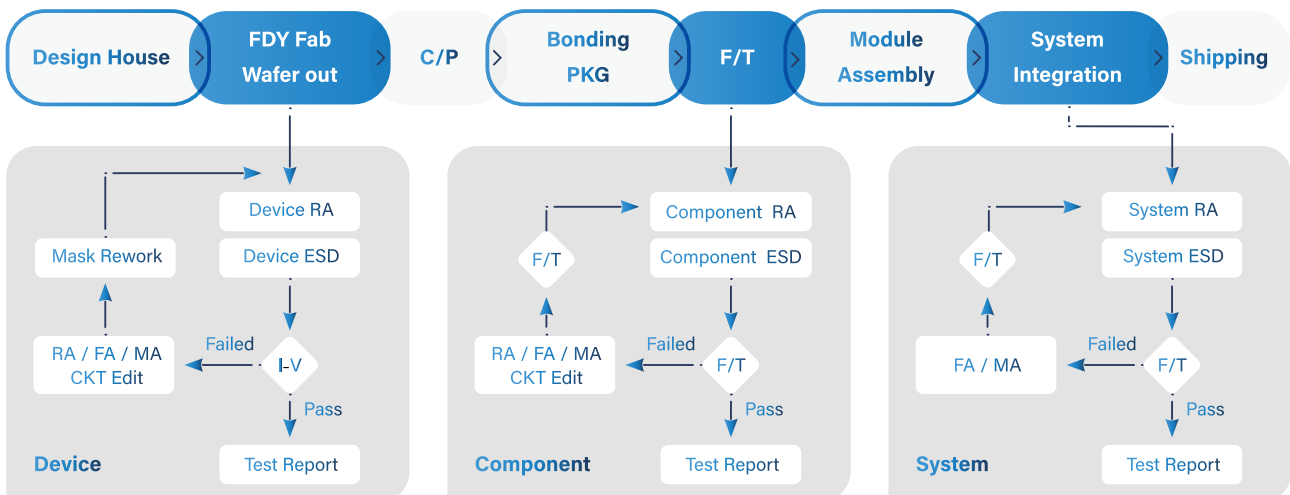


圖 1-9：產業鏈

4 · 願景

IC電子產品製程愈來愈精密，產品功能愈複雜的趨勢下，需要資本密集以投入次世代的分析設備。技術品質除了性能優良的設備與優秀的分析製備技術外，經驗豐富的工程人員更是成功不可或缺的一環。由於產品設計階段，樣品數稀少而珍貴，如何利用有限的樣品數，提供快速的分析服務找出設計的問題所在，才能具有競爭優勢。而閱康科技擁有在各個高科技產業深具經驗的菁英團隊，所開發出的各項專業分析技術，已經引領此領域的相關產業走向更高品質的知識服務導向。公司擁有在半導體、TFTLCD、光通訊、奈米研究、太陽能電池等產業經驗豐富的員工，除了能精準找出產品問題所在，與客戶共同研發新型分析技術，更可以提供客戶更高附加價值的智權策略服務。

為強化產業領導地位，並維護得之不易的先進技術成果，閱康科技於2021年導入TIPS管理制度，期望透過TIPS智財管理制度的落實，擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產發展策略，運用標準化研發作業流程管理，經由專利檢索、獎勵制度、教育訓練等執行層面的落實，引領研發團隊將開發出來的各項創新分析技術轉化成公司的專利智財資產，藉以提供客戶更高附加價值的智權策略服務。同時，也希望進一步藉由智財揭露制度的建置，對外提供更完整充足的智財資訊，使相關投資人及客戶能夠藉以深入了解公司強大的智財能量。此將有助於強化企業創新專業的形象，吸引更多訂單或投資，有效提升公司的營收成長，並成為全球科技產業最佳的研發夥伴。

另外，為有效保障客戶機密及公司研發成果，並避免因營業秘密受到侵害造成經營管理之風險，閱康科技自2024年也逐步展開「機密資訊管理制度」導入。目前公司已成立「機密資訊管理組織」，授權其負責推動機密資訊管理制度所建置之各項程序之管理、執行與落實。同時，也已完成了「機密資訊管理規範」之制訂、並正式公佈實施。藉由該管理規範所列之保密規定與措施，確保公司的各類重要資訊，包括商業經營策略及技術創新等內容，均能得到妥善及適當之保護。



核心技術分析

基本資料與組織簡介

1 · 企業核心技術說明

閱康科技提供三大服務內容為材料分析、故障分析以及可靠度測試。各主要服務內容與營收占比說明如下：



材料分析
透過物理性與化學性方式，查看材料結構狀況，找出影響產品功效原因，協助客戶找出解決方法。

故障分析
協助客戶發現故障發生原因，並採取矯正措施解決與預防再發生。

可靠度測試
研究元件並利用數學統計分析、評估改善，期能預測元件生命週期，再將分析結果反應於製程上。

圖 2-1：閱康科技提供之三大服務內容及服務銷售概況

材料分析

本服務內容主要透過物理性與化學性方式，查看材料結構狀況以找出影響產品功效的原因，幫助客戶在製程上找到最有效率的解決方法。

故障分析

藉由收集基本資料後進行分析規劃，例如第一階段會執行電路分析、X-Ray、超音波掃描檢測 (SAT)、紅外線熱感試驗等非破壞分析，完成初步的報告。若確定故障會發生，則會進行第二階段的電性故障分析 (EFA)，包括電性 I-V 測試參數、靜電放電測試 (ESD)、EMMI/InGaAs、OBIRCH 等；以及第三階段的物性故障分析 (PFA)，包括封裝去除 (De-Cap)、層次去除 (De-Layer)、掃描式電子顯微鏡 (SEM)、歐傑電子能譜分析 (Auger)、聚焦式離子束顯微鏡 (FIB) 等等。執行以上分析可以幫助客戶找出發生故障的根本原因，再採取矯正措施並解決與預防再發生的根本解決方案，精確、準確且效率地解決客戶在研發設計上遇到的問題，提供 IC 設計產業在產品開發工程階段最需要的服務項目。

可靠度測試

為電子產品在量產前必須要進行的信賴度、安全性、設計面測試，預期產品銷售後，在使用壽命期間內會有多少產品失效，同時也可藉由可靠度測試結果推估在保固時間內會有多少比例的退貨產品。可靠度測試藉著研究元件的物理機制，並利用數學統計之分析技巧，進行元件評估改善工作，期能完整地預測出元件之生命週期，再將其分析結果反應在製程上，求得製程參數的改進，如此更可確保元件衰退期的延緩。

再以技術層次區分，本公司的分析技術服務主要可分為九大類，服務範疇涵蓋了電子產品設計階段的快速除錯與實體驗證，以及微、奈米產品元件故障區域的精準定位、結構觀察、材料成分等各種靜態、動態測試分析；舉凡製程開發、製程整合、基礎學術研究、品質管制、專利訴訟、故障分析、競爭產品結構分析或客戶退貨相關的各類問題皆在服務範圍之內。



圖 2-2：閎康科技的分析服務技術

2 · 企業核心技術及其衍生 產品之競爭優勢分析

產業環境現況及主要市場分布

本公司為提供半導體產業之產品研發、製造及品質管理所需分析服務之獨立實驗室，主要業務為協助 IC 設計業對產品設計所發生問題進行分析驗證，並以 IC 材料及結構等專業分析能力，提供中下游 IC 製造與封裝測試等產業相關製程之問題分析，以提高產品良率及品質，屬於半導體產業產品之工程服務業。

(1) 全球半導體產業現況

2025 年上半年，全球半導體市場延續 2024 年的強勁復甦走勢。根據 WSTS 的最新預估，2025 上半年市場規模約達 3,460 億美元，呈現顯著年增長。雖然不同研究機構在統計資料上略有差異，但整體趨勢顯示，生成式 AI、資料中心擴建及高效能運算（HPC）需求仍是推動市場持續增長的主要動力。

回顧 2024 年，全球半導體產業已創下亮眼成績。根據 Semiconductor Industry Association (SIA) 統計，2024 年全球半導體銷售額達約 6,276 億美元，較 2023 年成長 19.1%，第四季單季更達 1,709 億美元，顯示需求全面回溫。產品結構方面，邏輯晶片 (Logic) 以 2,126 億美元居各類別之首；記憶體 (Memory) 則成為年度最大亮點，全年銷售達 1,651 億美元，年增率高達 78.9%，其中 DRAM 更達 82.6% 的年成長，反映記憶體行情與需求的明顯好轉。

市場動能的轉強，也推動製造端的資本支出提升。產業報告指出，2024 年下半年全球 IC 銷售與 CapEx 已出現回升，尤其記憶體領域的投資季增表現最為明顯。展望 2024 至 2026 年，全球半導體業者持續擴增先進製程、先進封裝與成熟製程（8 吋 / 12 吋）產能。美國、歐洲、日本與東南亞更因政策補貼及供應鏈地緣風險考量，成為區域化投資的重要據點。

從需求面來看，半導體應用正快速擴大並多元化。除了傳統消費電子產品回穩之外，AI 伺服器、高效能運算、電動車與車用電子、功率半導體（如 SiC）、物聯網等領域皆成為推升市場的重要引擎。國際顧問機構如 Deloitte、KPMG 等均強調，AI 是 2025 年半導體產業成長的核心驅動力，而人才缺口及地緣政治仍是企業在全球布局時面臨的主要挑戰。

整體而言，2024 年的強勢復甦為 2025 年奠定扎實基礎。在邏輯、記憶體與新興應用需求的三重支撐下，全球半導體市場不僅創下歷史新高，亦正式步入下一輪由 AI 與資料中心驅動的成長週期。

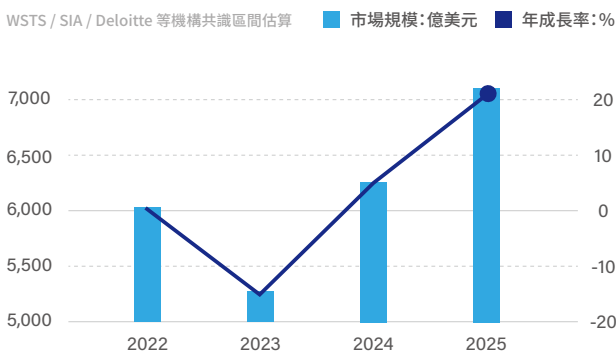


圖 2-3：全球半導體營收規模及年增率

(2) 我國半導體產業現況

台灣於 2025 年在全球半導體產業鏈中仍占據戰略樞紐位置，特別在先進晶圓代工與高階封裝領域，其技術能量與產能佈局持續深化。以台積電為核心的台灣供應生態系，正持續推進 3nm、4nm 以及下一代 2nm 製程技術的量產佈局，同時積極擴張 CoWoS、InFO、SoIC 等先進封裝產線，以支撐 AI、HPC 與資料中心對高頻寬封裝的爆發性需求。

目前台灣在全球晶片生產布局中，仍保有不可取代的技術與產能優勢。根據官方統計與產業研究機構的預測，2025 年台灣 IC 產業總產值將維持於高檔區間，其中晶圓代工與封裝測試仍為主要成長引擎。生成式 AI 與資料中心擴容帶來的算力需求，使先進節點晶圓與高階封裝呈現供不應求的態勢，而 2nm、3nm、4nm 等節點的全球可用產能高度集中，使各領先廠商之間的競爭態勢加速走向技術與產能的雙軌競逐。相較之下，成熟製程（尤其是 8 吋平台）在汽車電子、工控與電源管理 IC 等應用需求支撐下，維持溫和且穩定的利用率。為因應供應鏈區域化與多區域製造的長期趨勢，許多台灣成熟製程代工業者，正加速推動跨國合作與海外擴產佈局，以提升供應彈性與就近服務能力。例如，聯電 (UMC) 已與美國公司 Polar Semiconductor 簽署備忘錄，探討在美國生產 8 吋晶圓；世界先進 (VIS) 也與歐洲晶片廠商合作於新加坡興建 12 吋晶圓廠，以擴展海外產能、強化區域供應彈性與競爭力。這樣的跨國合作，正體現成熟製程代工與海外布局策略。整體而言，台灣半導體產業正處於先進技術深化、本地供應鏈強化與海外製造策略化布局三者並進的階段，並在全球價值鏈重組過程中持續擴大其技術與產能影響力。

從全球產業視角來看，台灣半導體於 2024 年之後已重新回到成長軌道。各項產業統計顯示，台灣依循其成熟的專業分工模式與高度整合的供應鏈體系，在全球半導體產值中維持僅次於美國的地位，並在晶圓代工、IC 設計、封裝測試、材料與設備等領域形成完整且具競爭力的生態系。伴隨 AI、雲端運算、車用電子與物聯網等應用的快速擴展，台灣業者的角色已從傳統的製造與封測中心，進一步深化至先進製程、高效能運算及 AI 伺服器所需之先進封裝的核心供應鏈環節。多份國際研究與機構分析亦指出，在 AI 驅動的技術升級及全球供應鏈結構調整的背景下，台灣半導體產業於 2024 至 2025 年的國際影響力與議價能力呈現持續提升的趨勢。

然而，產業亦面臨持續演變的外部風險。地緣政治緊張、出口管制強化以及美中科技競爭，正驅動全球供應鏈快速重組。主要經濟體（美、歐、日、韓、台）積極推動在地化與多源化供應策略，促使 2024 至 2026 年全球半導體製造與資本投資布局出現結構性重整。在此背景下，高階封裝因 AI 晶片需求大幅攀升而出現階段性供應

限制；同時，工程與製造人才不足、特種原材料與關鍵設備產能受限等因素，也對業界擴產能力與中長期競爭力構成結構性挑戰。對台灣而言，如何維持先進製程與封裝的技術領先、提升供應鏈韌性、強化本地人才培育體系，以及在美中競爭加劇的情勢下維繫國際客戶信任，將成為未來數年的核心課題。

整體觀察，2024 年象徵全球半導體產業自 2022 至 2023 年調整期後的明顯回升，並形成多項具長期影響力的結構性趨勢：記憶體與邏輯產品需求同步增強、AI 與 HPC 推動伺服器市場全面升溫、供應鏈區域化加速、資本支出重回成長但競爭更趨激烈。進入 2025 年，全球半導體產業將步入由生成式 AI 與資料中心擴建帶動的新一輪成長周期。在此過程中，台灣憑藉其先進製程與先進封裝能力，以及高度完備的供應鏈生態系，持續保持不可替代的戰略地位，並在全球半導體價值鏈中的影響力進一步提升。

(3) 閎康科技所屬產業現況及挑戰

當前全球半導體產業正處於技術快速演進與應用多元化拓展的關鍵階段。閎康科技所屬的半導體分析與檢測領域，受益於全球半導體市場復甦，以及生成式 AI、高效能運算（HPC）等高端應用對晶片可靠度與材料解析的持續需求。然而，地緣政治緊張、供應鏈重構及高階技術人才短缺等因素，也對產業發展形成長期挑戰。對閎康科技而言，產業現況的影響可概括如下：

1. 高階材料分析與可靠度測試需求增長

隨著製程持續微縮、異質整合與先進封裝技術推進，半導體元件結構日益複雜，對材料特性、結構完整性及失效機制的解析需求顯著提升。閎康在穿透式電子顯微鏡（TEM）、聚焦離子束（FIB）、失效分析與壽命評估等領域具備核心技術能力，可提供先進製程驗證所需的關鍵技術支援。

2. AI、HPC 及車用電子推動高規格驗證需求

AI 與資料中心晶片對效能及可靠度要求極高，車用電子產品需符合 AEC-Q100 車規標準。閎康科技在長期可靠度測試與異常失效分析方面具備領先優勢，能滿足高端應用對第三方技術驗證的嚴格規範。

3. 晶圓代工與 IC 設計公司對分析服務依賴增強

隨著半導體公司聚焦核心設計並加速產品上市，對專業分析實驗室的需求日益增長。閎康科技憑藉快速反應能力與技術專長，提供即時、精準且具彈性的客製化服務，成為客戶產品驗證流程中的重要合作夥伴。

4. 地緣政治與供應鏈在地化帶動區域化分析需求

全球供應鏈重組與地緣風險推動各國半導體在地化生產。閎康科技在台灣、中國及日本的據點布局，提供區域製造業技術驗證與品質保證支援，進一步強化其在亞洲半導體生態系統中的戰略地位。

5. 早期研發階段的技術驗證參與

為降低量產風險及優化設計流程，半導體公司日益在產品開發初期導入第三方分析資源。閎康科技持續強化先進材料、介面結構與失效機制的研究能力，有助於在研發初期與客戶建立深度合作，提升產品成功率及信賴度。

因應前述產業趨勢與挑戰，閎康科技在市場與技術面布局的重點策略如下：

1. 強化在地服務與全球據點布局

積極拓展台灣、中國及日本等半導體核心地區的實驗室與服務據點，提供快速、靈活的技術支援，並深化與晶圓代工、IC 設計公司及封裝測試廠的合作網絡。

2. 聚焦高成長應用領域

專注於 AI 晶片、車用電子、矽光子及寬能隙半導體（SiC、GaN）等關鍵市場，提供客製化失效分析與可靠度驗證服務，滿足高階應用對技術精度及可靠性的需求。

3. 建構策略聯盟與產業合作網絡

與晶圓代工廠、設備供應商及學研機構建立長期合作，提前掌握技術節點轉換趨勢，並共同開發次世代驗證解決方案，持續提升整體技術競爭力。

藉由這些策略，閎康科技不僅將深化其在先進製程與高階封裝分析領域的領導地位，也將持續擴張在全球半導體生態系的戰略影響力。



MATEK

主要國內 / 外競爭對手與競爭優勢分析

相較於全球其它提供分析檢測服務的供應商，閱康無論在儀器設備、分析技術、檢測品質與交期、或是產業服務涵蓋範圍等，皆大幅領先業界，具有絕對的市場競爭優勢。

1 分析設備先進齊全

由於相關儀器 TEM (穿透式電子顯微鏡)、SEM (掃描式電子顯微鏡)、FIB (聚焦式離子光束機)、SIMS (二次離子質譜儀) 等購置金額昂貴，僅學術單位或資源豐富的半導體廠備有機台，未能普及於產業界。

閱康科技是目前國內規模最齊全的材料分析實驗室及電子電機實驗室，無論是設備型號、機台數皆遠優於各大學和研究機構，在世界上居於領先的地位。

2 技術能量既深且廣

閱康的分析服務涵蓋了電子產品設計階段的快速除錯與實體驗證，以及微、奈米產品元件故障區域的精準定位、結構觀察、材料成分等各種靜態、動態測試分析；舉凡製程開發、製程整合、基礎學術研究、品質管制、專利訴訟、故障分析、競爭產品結構分析或客戶退貨相關的各類問題皆在服務範疇之內。閱康科技擁有來自各種不同高科技產業領域深具經驗的分析服務團隊，其所開發出來的各項專業分析技術，已經引領此領域的相關產業走向更高品質的知識服務導向。

3 規模化高品質服務

閱康成立的目的是推廣材料分析應用至各領域的研發、製程與品管，提升工業界產品研發的速度。為了能夠與客戶緊密結合、更貼近客戶提升服務，閱康陸續在竹北台元科技園區、新竹科學園區、台南科學園區、上海張江高科技園區、廈門湖里區紮根，並於 2019 年進軍日本名古屋成立材料分析實驗室。同時，為了提升客戶服務品質及效率，自行開發 UFAST 客服系統，無論開案、技術諮詢及報價，都能以線上形式及時獲得技術團隊及客服人員的完整服務。除此之外，透過全新智慧化實驗、資訊系統化、製程標準化及產線自動化，隨時掌握人員、工單、機台狀況及實驗進度。期能提供客戶標準化與效率化的高品質分析服務。



研發策略與資源

基本資料與組織簡介

1 · 研發策略與方向

當半導體製程線寬逐漸縮小時，現有鳍式場效電晶體 (FinFET) 結構的垂直設計將會碰上空間跟技術上的挑戰，其發展也因而面臨了須再進化的階段。而下一代「環繞式閘極結構」(Gate-All-Around, GAA) 的鳍式電晶體節點構造，將取代目前鳍式場效電晶體，成為市場主流技術。而隨著高頻通訊、電動車的時代到來，第三代寬能隙半導體市場成了兵家必爭之地，其重要應用產品包含 5G 通訊晶片型電源轉換器，微型電源轉換器及車用高電壓電源供應器等。第三代半導體技術的快速發展，產業鏈包括晶圓、磊晶、元件設計、元件製造到封裝的研究開發與良率改善等，其故障分析與材料析的需求也日益迫切。

在新興科技方面，隨著矽光子技術的快速發展，其在資料傳輸、雲端運算及高效能運算 (HPC) 中的應用正日益受到重視。矽光子整合光學與電子元件於單一晶片上的能力，不僅能顯著提高數據中心和通訊網絡的傳輸效率，也具備降低功耗與成本的潛力。閎康科技基於市場需求及技術趨勢，正積極規劃矽光子技術相關的分析服務，包含半導體先進製程結構、材料組成分析及缺陷檢測，並強化矽光子晶片的品質及可靠性驗證，協助客戶搶占新興市場先機。另外，AI 人工智慧發展也是近幾年資通訊產業最關注的議題。半導體產業相關晶片的 HPC 高效能算能力大幅提升，預期此將帶動 AI 人工智慧更為廣泛的被應用到各個領域，工業 4.0、智慧城市新零售、智能家居，並於未來普遍應用到日常生活中，帶來大規模的新興產業商機。

基於上述對於半導體市場發展趨勢的觀察，並考量既有客戶的產品分析需求，閎康科技在研發策略及方向上規劃，短、中、長期內容說明如下：

短期



因應半導體產業技術發展的急切需求，短期研發方向以開發五大類別高值產品「寬能隙半導體」、「GAA電晶體」、「先進封裝」、「矽光子晶片」、「AI處理器」所需之創新分析技術及設備為主。

中期



研發中心與業務部門密切合作，藉由業務團隊對未來市場的專業分析，朝高值與利基產品布局核心分析技術專利，藉以形成技術壁壘，保障本公司研發成果及其權利，並創造未來價值與競爭力。

長期



閎康擁有在各高科技產業深具經驗的技術菁英團隊，面對客戶困難多樣的分析需求時激盪出創新技術構想。運用標準化研發作業流程管理，經由專利檢索、獎勵制度、教育訓練等執行層面的落實，引領研發團隊將開發的各項創新分析技術轉化成公司的專利智財資產，提供客戶更高附加價值的智權策略服務，強化閎康在全球市場之優勢地位。

2 · 企業研發資源與能力

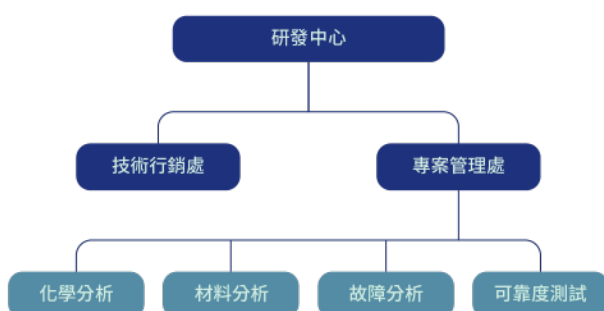


圖 3-1：研發組織圖

研發組織圖

閎康科技重視分析技術的研發，內容包含樣品前處理、樣品盛裝容器、分析流程創建及優化、機台改良、輔助治具和軟體建置等。閎康內部研發團隊除了研發中心成員外，也包括公司各大分析事業群的技術專家；而研發專案則包括材料分析、故障分析、化學分析、及可靠度測試四大類別。

所有研發專案主要皆由研發中心來統籌管理及審查，任一研發專案自各技術事業群提出、並通過研發中心評估審查之後，由所屬分析事業群的技術團隊與研發中心所屬類別成員共同完成。目前各類別研發專案團隊主要研發方向如下：

01

材料分析

先進製程、化合物半導體、前瞻光電及感測應用等的關鍵材料與結構分析、AI 智慧影像與數據分析軟體、大量樣品分析流程管理及優化方法等相關創新技術開發。

02

故障分析

先進製程、異質整合、三維晶片堆疊 (3D IC)、扇外型晶圓級封裝 (FOWLP)、小晶片 (Chiplet) 模組等晶片失效分析、高頻及儲能元件失效分析、先進晶片線路修補與樣品製備等關鍵技術開發。

03

化學分析

液態樣品電子顯微鏡 (Liquid-TEM) 分析、生醫與軟質樣品製備、物理化學特性分析、質譜分析方法優化等相關創新技術開發。

04

可靠度分析

車用電子可靠度測試、ESD 測試及線路設計、工程樣品封裝、測試設備與治具改良等相關核心技術開發。

各技術領域研發重點

研發人才組成

閱康科技自創立以來即相當注重員工的研發能力，全球員工中，平均研發人才佔總員工的 4.4% 以上；再以學歷作為區分，專精實務技術的專科人才占比約 67%，而深入扎根基礎理論的碩博士研發人才合計也達到約 34%，這也佐證了閱康科技延攬高級人才的理念。

	2022	2023	2024	2025
人數	53	68	59	69
佔比	5.1%	5%	4%	4.4%

表 3-1：研發人員佔比

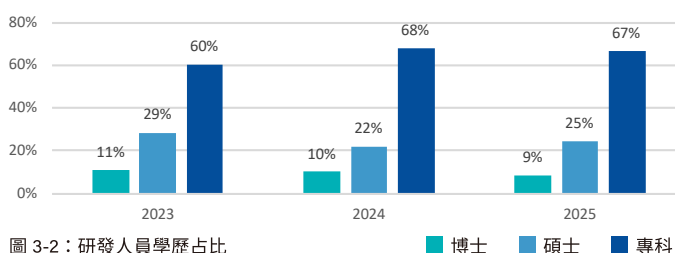


圖 3-2：研發人員學歷占比

此外，閱康科技長期協助高科技產業在先端技術的分析檢測需求，獲得業界的好評與信賴。自2021年起，攜手科技部針對台大、清大、陽明交大、中央、中興、成大、中山、台師大等八所國立大學成立產學合作計畫，提供每年新台幣 2,000 萬元的研發經費，補助20件專案，以支持國內學術界在創新元件、材料及創新構想的先期研究及開發，並提升學界研發過程中的分析技術。

目前產學合作計畫的執行，已順利邁入第五年。2025年的第五屆產學合作計畫徵稿於5月初正式啟動，並在7月中旬時公告核定合作教授名單。隨後，在10月9日也成功舉辦了期初交流會，誠摯邀請約20位獲選合作案的教授及其研究團隊前來閱康科技總公司參訪。

本期 114 年度計畫申請踴躍，各校提出的計畫涵蓋範圍廣泛，研究主題包含半導體材料、先進元件與製程、量子計算、矽光子、6G通訊、新能源、太空輻射、記憶體、感測器、安全晶片、高熵材料、奈米醫藥 (K-kit) 及 AI 等前沿科技領域，展現出國內學術界的研究能量與多元創新。而因應全球綠能與永續發展趨勢，「新能源」研究領域申請件數顯著增加，與「先進材料與封裝」並列為最熱烈的申請主題。

閱康科技將產學合作視為永續經營的核心策略，聚焦人工智慧、矽光子、電動車、安全晶片、低軌衛星、綠能環保及奈米生醫等前瞻技術領域，並聘請國內外專家學者擔任顧問，涵蓋生物醫學、失效分析、表面分析、可靠度分析及靜電測試等技術類別。公司透過資源支持與專業檢測，協助學界研究成果加速轉化為實際創新，並積極推動論文發表、專利布局及產業鏈結，創造最大產業價值。未來，閱康科技將持續深化與學界的長期合作，鼓勵教授踴躍申請計畫，確保產學合作持續推動與規模擴大，實現產學雙贏與共榮藍圖。



圖 3-3：研發量能

企業研發資源成果

2025 年公司投入研發之經費與研發投資額占整體營業額之比例，如表 3-2 與圖 3-4 所示。相較 2022 年至 2024 年，2025 年的研發占比略為下降，主要原因是公司基於總體投資發展策略的考量，調整並降低中國大陸部分實驗室之研發資源投入。然而，公司整體研發投入仍維持在 4.5% 以上，展現持續深化技術能量的決心。

	2022	2023	2024	2025 (截至11月底)
研發費用	223.5	265.9	289.7	209.9
總營收淨額	3,974.0	4,809.0	5110.4	5043.9
占總營收淨額比例	5.6%	5.5%	5.7%	4.2%
研發費用/ 公司成本支出占比	6.9%	6.6%	6.6%	4.6%

表 3-2：研發投資概況

單位：新台幣百萬元

閱康科技作為具高度技術門檻的分析檢測實驗室，長期專注於稀有且昂貴的精密分析儀器之應用技術開發，並結合專業顧問的技術諮詢能量，精準提供多元的試片製備與分析服務，以支援客戶在電子產品研發、新材料結構設計及製程開發上的關鍵需求。

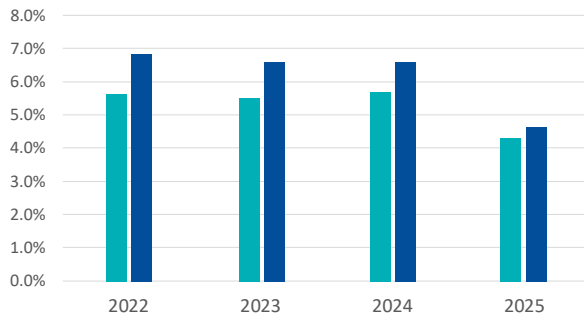


圖 3-4：研發支出占比



智財策略管理與成果應用

智財策略與目標

1 · 智財策略與目標

智財策略

落實 TIPS 管理制度的執行，獎勵智慧財專利申請、並且持續精進機密資訊管理制度，藉以全面強化員工在客戶機密資訊保護及智財管理方面的認知，並提升專利知識的品質與數量，以確保自身研究開發成果，維持公司於業界的創新研發與技術領先優勢。

研發中心與業務部門密切合作，藉由業務團隊對未來市場的專業分析，擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產發展策略，朝高價值與具基礎產品布局核心分析技術專利，藉以形成技術壁壘，保障公司研發成果及其權利，並創造未來價值與競爭力。

閱康擁有在各高科技產業累具經驗的技術菁英團隊，面對客戶因難之特殊分析需求時激盪出創新技術構想。運用標準化研發作業流程管理，結合專利檢索、獎勵專利、教育訓練等技術管理要項，引領研發團隊將開發的各項創新分析技術轉化成公司的專利智慧資產，提供客戶更高附加價值的智慧財策略服務，強化閱康在全球市場之優勢地位。

短期

中期

長期

智財目標

依據 TIPS 規範落實研發管理流程、獎勵智財申請、並逐步強化員工在智財與機密保護方面的教育訓練。據此，每年增加專利申請數量成長至少 10%，再者，為了讓客戶及投資人完整了解公司研發方向及智財成果，擬定智財揭露機制並公開智慧財產報告書。

深化 TIPS 智財與機密資訊管理制度的執行，並成立專責智財管理與法務部門。依據公司營運目標與研發資源的智慧財產發展策略，對所需技術智財進行完整專利布局。

持續精進智慧財產取得、保護、維護與應用等管理系統與措施，將專利資產經由授權、移轉、或是將其發明內容應用於分析服務技術或是產品上。充分活化智財應用，使其實際轉化成營收獲利，成為維持公司永續發展的競爭力。透過智財揭露機制，持續展露公司之智財實力及競爭優勢，穩固既有合作關係並挹注投資動能。

2 · 智財管理制度或實施方式

智財策略

(1) 台灣智慧財產管理制度

閎康科技為強化產業領導地位並維護得來不易的先進技術成果，自 2021 年 7 月 21 日起正式導入「台灣智慧財產管理制度 (TIPS)」，並於同年 12 月 6 日首度通過 A 級驗證審查。迄今制度已穩健運作近五年，透過專利檢索、獎勵制度與教育訓練等機制的持續落實，成功引導研發團隊將創新分析技術轉化為公司的專利與智財資產。

隨著 TIPS 制度日益成熟並展現良好成效，為降低外部稽核對營運的干擾及節省行政資源，經最高管理階層 (總經理) 指示，自 2025 年起將不再申請資策會 TIPS A/AA 級資格認證，改以自主強化管理機制，持續推動制度優化。為確保自主管理與內部稽查能更完善落地，本公司於 2025 年安排 4 位 TIPS 工作小組成員參加外部教育訓練並取得 TIPS A 級自評員資格；同時，TIPS 管理代表亦已於去年完成進階課程，取得 TIPS AA 級自評員資格。



圖 4-1：閎康科技之智慧財產管理制度

智慧財產之研發與管理

(1) 智慧財產之研發：

研發產出單位會依照市場需求或公司技術發展之需要，經相關智財資料、資訊之檢索分析等評估後，進行研發作業項目之申請。於研發過程中亦會留存研發及創作紀錄，以利日後紛爭發生時進行發明及創作歷程之舉證。閎康科技會協調公司內外部相關單位就公司內之研發成果進行驗證，以確保研發作業合乎規劃之要求。若研發案擬公開，則須經由公司內部審查並獲准後，方得對外公開取經許可之內容，以落實研發成果控管。

(2) 智慧財產之提案、申請與管理流程



✓ 智慧財產權之提案、評估

為落實閱康科技專利、商標、營業秘密、著作權之保護與管理，提案人就研發或創作成果向管理單位提案申請專利權或商標權，經提案人主管審查評估簽核許可後交予管理單位協助辦理申請評估。

✓ 智慧財產之審查會議

管理單位受理提案後將召開審查會議，若該提案通過申請專利權或商標權之審查，單位協助將提案資料提供予本公司合作之外部顧問或代理人進行提案評估，並協助提案人就外部顧問或代理人提供之評估報告轉予提案人審閱並依情況對相關內容進行修正或補充。

✓ 提出智慧財產權申請

於專利申請階段，管理單位將外部顧問或代理人完成之專利說明書提供給提案人審閱。提案人需確認專利說明書中關於提案的技術描述是否正確。待提案人確認技術描述無誤之後，管理單位始得指示外部顧問或代理人正式提出專利申請。

✓ 智慧財產權管理及維護

建立智慧財產權之盤點清冊，並定期更新及維護其紀錄，於權利期限屆滿前會進行維護效益評估並決定是否繼續維護相關權利。

✓ 機密資訊之管理及維護

閱康科技訂有嚴密的機密資訊管理辦法，針對文件性質區分為不同機密等級並設定相關接觸人員權限，確保僅有必要人員可以接觸相關機密資訊。
 針對員工進行保密相關教育訓練，強化員工認知。
 每年進行內部稽核，確保相關保密措施皆嚴格執行，落實資安防護。
 通過「ISO27001(資訊安全)、ISO15408(IT Security Evaluation)、台灣智慧財產管理制度 TIPS A 級驗證」等多項專業管理系統驗證，且定期接受外部稽核認證機構之審核，足資證明機密資訊獲得嚴密控管。

圖 4-2：專利 / 商標之提案審查、申請與管理流程圖

(3) 智慧財產相關獎勵辦法

公司針對不同智財類型與申請地區，制定對應的專利與商標「申請獎金」與「獲權獎金」。此外，專利技術內容經審核後，若符合公司策略方向或業務拓展需求，即認為「關鍵專利」；若具備創新應用潛力、可實質提升產能或帶來營收貢獻，則認為「核心專利」。所述之兩類專利因對公司營運具有重大價值，其獲權獎金將以加乘方式發放，以鼓勵員工投入高技術價值之智慧財產開發。



圖 4-3：智慧財產相關獎勵辦法

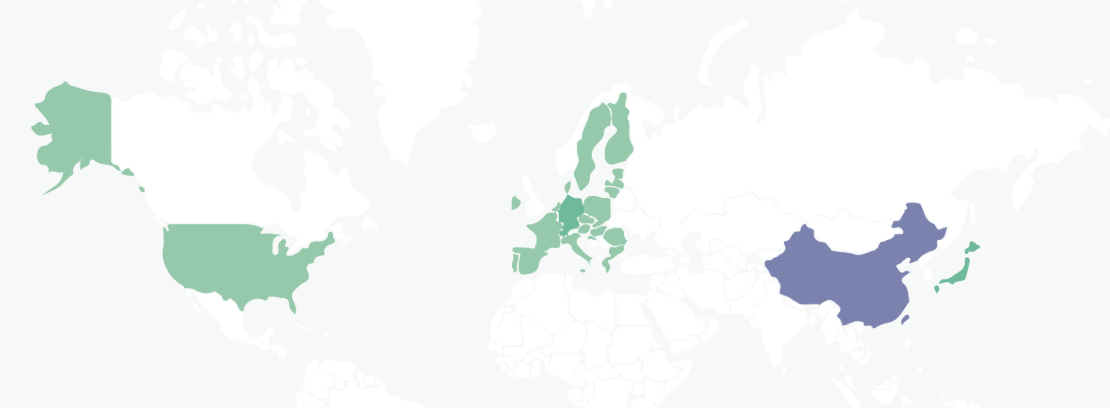
3 · 智財清單 / 智財成果

智慧財產清單資料包含公司所擁有之專利與商標，專利包含發明專利與新型專利經核准與申請中的數量，並且針對各國專利之數量個別記錄；商標包含經核准與申請中的項目，各資料數據係統計至 2025 年 11 月 30 日為基準。

(1) 專利權

閱康科技的優勢在於領先競爭同業的高階技術服務，因此並非以提升申請專利數量為主要目標，而係以申請具有高品質、高穩定性、高價值之專利為策略，重視於所申請專利之進步性及有效性，尤其將資源集中投入於分析測試領域專利之研發。

截至 2025 年 11 月為止，閱康科技台灣母公司及大陸子公司總共提出 261 件專利申請。其中，已獲核准審定的「發明專利」為 65 件、「實用新型」專利為 101 件，申請地區涵蓋台灣、大陸、日本、美國、及歐洲。



申請地區		台灣	中國大陸	美國	日本	歐洲
發明專利	已獲核准註冊數量	18	15	14	14	4
	申請中數量	17	28	18	17	1
新型專利	已獲核准註冊數量	1	99	0	1	0
	申請中數量	0	14	0	0	0

圖 4-4 / 表 4-1：地區專利申請概況

2023 年至 2025 年分別提出了 38 件、19 件、27 件專利申請，而先前提申專利獲核准審定者為 22 件、23 件、17 件專利，上述專利申請與核准數之資料範疇涵蓋台灣母公司及大陸子公司，專利申請、專利核准件數統計如圖 4-5。

閎康科技主要將研發資源集中投入於開發分析測試領域的創新技術，其所產出之專利，以材料分析 MA 與故障分析 FA 數量佔比最高。而關於所有專利技術類型的分類統計結果，如圖 4-6 與表 4-2 所示。

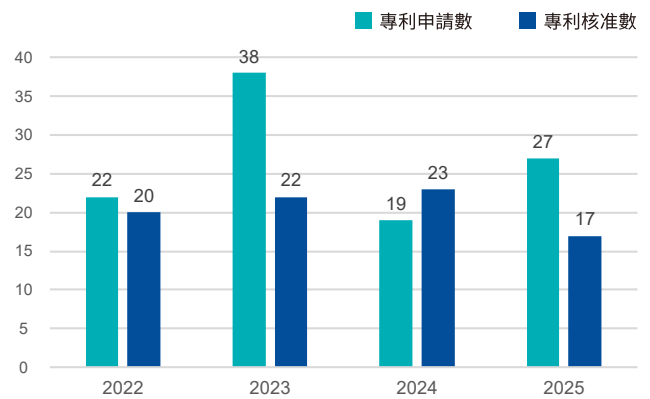


圖 4-5：專利申請、專利核准件數統計

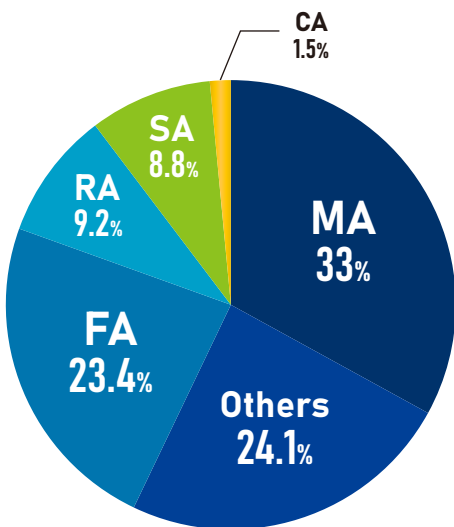


圖 4-6：研發資源投入比例圖（以 IPC 分類技術領域）

種類	申請件數	核准件數
材料分析 MA	9	77
表面分析 SA	6	17
故障分析 FA	7	54
化學分析 CA	0	4
可靠度測試 RA	10	14
其他 Others	63	0

表 4-2：專利類型分類統計表（以檢測技術服務類型進行區分）

(2) 著作權

隨著半導體及材料產業的快速發展，閎康科技除了提供專業完整的分析服務外，並由公司內部同仁定期撰寫技術文章刊登；於 2021 年第四季正式啟動產學合作計畫後，特別在公司網站的技術文章專區開設「科技新航道」專欄。

自 2020 年至 2025 年 11 月止，共有 102 篇文章刊登，所涉技術領域之分布如圖 4-7。

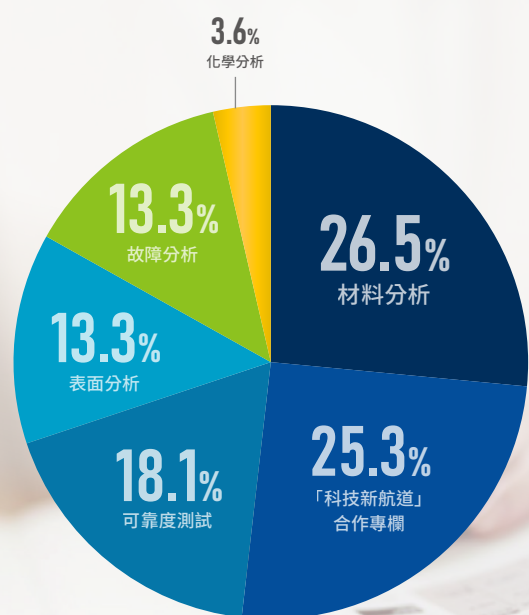


圖 4-7：刊登文章所涉技術領域之分布

表 4-3：近 13 篇刊登之技術文章

	二維半導體的新戰場：硒氧化鈹電晶體 ——國立清華大學 電機系 邱博文 教授	科技新航道 合作專欄 2025.01
	次世代儲能技術：先進鋰硫電池 ——國立成功大學 鍾昇恆 副教授	科技新航道 合作專欄 2025.02
	矽光子技術促進先進高效能計算 ——國立陽明交通大學 李佩雯 教授	科技新航道 合作專欄 2025.02
	銅混合接合技術的創新突破：三維積體電路與先進封裝的關鍵技術 ——國立陽明交通大學 陳冠能 教授	科技新航道 合作專欄 2025.03
	閱康創建功率元件完整性的驗證服務模式 ——閱康科技技術團隊	RA 可靠度試驗 2025.04
	探索車用模組的驗證世界 ——閱康科技技術團隊	RA 可靠度試驗 2025.05
	秒懂 2025 年版 AQG 324 規範亮點 ——閱康科技技術團隊	RA 可靠度試驗 2025.05
	矽光子技術：開啟未來高速光通訊的大門 ——國立陽明交通大學 郭浩中 教授	科技新航道 合作專欄 2025.06
	氮化鎵晶片之靜電放電防護技術介紹 ——國立陽明交通大學 柯明道 教授	科技新航道 合作專欄 2025.07
	AEC-Q006 2025 版 關鍵變更全解析 ——閱康科技技術團隊	RA 可靠度試驗 2025.08
	洞悉微小缺陷，守護卓越品質－空洞不再是難題， 真空回流焊打造高可靠的SMT焊接品質 ——閱康科技技術團隊	RA 可靠度試驗 2025.09
	3D IC 封裝：異質接合技術發展及以臨場升溫 原子力顯微鏡輔助製程設計 ——國立陽明交通大學 陳智 講座教授	科技新航道 合作專欄 2025.01
	節能鐵電氧化鉛銻於能源領域理論與應用 ——國立臺灣大學 李敏鴻 教授	科技新航道 合作專欄 2025.11

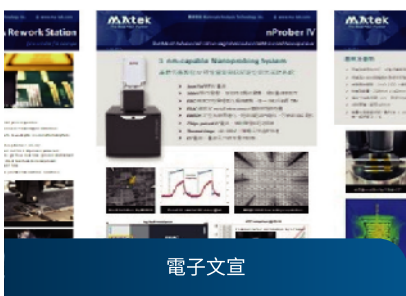
(3) 商標權

閱康科技是分析檢測領域的國際領導廠商之一，其提供超過 650 項的分析檢測服務，客戶分布在台灣、中國、美國、日本、新加坡、馬來西亞、及歐洲等地區，並且全球也有高達 23 家知名的通路商，代理銷售獨家專利產品 K-kit。為了讓客戶有效識別閱康科技於市場上的分析服務內容及產品，並且清楚表彰公司的品牌形象，藉以達到行銷推廣目的，目前閱康科技已在台灣、大陸、日本、及美國四大地區提出共 8 款商標設計，其中經核准商標註冊登記者約有 66 件。所有註冊的商標依功能及設計目的不同，已廣泛使用在例如官方網站、社群媒體、廣告文宣、產品包裝、展會佈置等，讓消費者得以透過商標清楚認識高品質的產品及服務來源來自閱康科技，並維護自身建立多年的良好市場商譽。右表與下方圖例是目前閱康科技已獲核准商標註冊登記的概況及商標實際使用範例。

商標圖樣	登記註冊件數	指定使用之商品或服務類別	註冊地
	8	09	台灣、大陸、日本、美國
	1	09	大陸
	8	09, 41, 42	台灣、日本、美國
	11	09, 41, 42	台灣、大陸、日本、美國
	10	09, 41, 42	台灣、大陸、日本、美國
	12	09, 41, 42	台灣、大陸、日本、美國
	12	09, 41, 42	台灣、大陸、日本、美國
	4	09, 41, 42	日本、美國

表 4-3：商標註冊之數量、類別與地區

圖 4-8：商標使用情形 (下)



4 · 企業所擁有的智財之主要用途，及其對企業營運的主要貢獻

閱康科技是一家兼具高度專業技術及先進貴重儀器的分析檢測實驗室，能以優質快速的樣品製備及分析服務，滿足客戶在設計研發、生產製造、系統功能驗證、以及失效分析等方面的各種檢測需求。事實上，閱康科技之所以在營收表現上能夠大幅超越同業，最主要還是來自持續不斷的研發投入與智財能量累積，構築出強大的技術創新動能與市場競爭力。目前閱康科技所擁有的豐沛智慧財產，已為公司在各個面向的發展，茲就本公司智慧財產之主要用途及因此所生實質效益，說明如下：

增加 產值



提升分析效率、優化設備及檢測方法、提高品質及獨家產品販售，大幅增加總體營收產值

閱康科技已實際藉由自有專利的實施，大幅提升分析效率、改善設備治具、優化檢測方法、提高樣品製備品質、對外販售獨家產品，來增加公司營收產值。舉例來說，閱康科技針對液態樣品電子顯微鏡影像觀測所開發的創新產品技術 K-kit，已於國內外市場進行完整的專利布局及商標註冊，有效保護該產品技術及品牌形象，並提升海外經銷商或代理商的銷售合作意願；此外也基於此創新產品技術，對外提供高值液態樣品電子顯微鏡分析服務。目前 K-kit 產品除了在國內由閱康科技自行販售外，也同時於美國、歐洲、澳洲、日本、大陸、韓國等地區共 23 家知名通路商銷售，為公司提升年獲利至少新台幣 2,000 萬元。

再者，閱康科技也將分析檢測方面關於「流程優化」及「試片管理」的專利，實際應用在營運的分析服務中。公司每天來自客戶委託的分析樣品高達數百顆，且多數需在 24 小時內完成出貨，面對如此龐大數量的例行檢測分析需求，稍有不慎即有可能面臨樣品損壞或遺失風險；此外，要達到在 1 天內完成檢測、並提供正確報告書給客戶的承諾，如何實現高效快速的量產模式分析服務，「流程優化」及「試片管理」絕對是項艱難挑戰。目前閱康科技藉由獨家專利技術的應用，得以縮短每案所需分析時間 50% 以上，大幅提升總體營收產值。

強大的專利智財能量是技術競爭力的展現，也是投資或政府評估補助的重要參考指標

閱康科技已於 2021 年導入 TIPS A 級管理制度，透過 TIPS 管理制度的執行，有助於落實標準化研發作業流程管理，經由執行專利檢索、獎勵制度、教育訓練等措施，引領研發團隊將開發出來的各項創新分析技術轉化成公司的專利智財產，提供客戶更高附加價值的智慧策略服務。

目前閱康科技已申請的專利總數超過 260 篇，在申請數量也逐年快速提升，所展現的強大技術創新實力。更實質獲政府機關及各主辦單位肯定，並取得產業政策發展相關經費補助。例如國內之產業升級創新平台輔導計畫、2022 年根留臺灣企業加速投資行動方案及 2022 年智慧機械投資抵減專案等，閱康科技皆已通過申請、獲得經費補助。其中，根留臺灣企業加速投資行動方案，閱康科技已成功申請了 2 期，獲得政府補助總經費達新台幣 30 億元。

此外，閱康科技在大陸地區也因為所展現現有創新技術與智財實力，連續數年成功爭取到包括上海高新企業認定，以及數個地方型企業獎勵方案補助。也同時獲得「2021 年上海專精特新企業」及「2021 年浦東新區企業研發機構」殊榮認定，此對於未來在其它研發專案的經費補助申請，亦將有極大的幫助。

閱康科技的專業性及創新能力，不僅擁有關鍵核心技術，更是品質與效益兼優的典範企業。其依循 TIPS 智財管理規範，於產品開發初期經由嚴謹的專利檢索及提案審查，避免投入大量研發資源在侵權產品的產品開發上。此外，平日對於員工的智財及保密知識教育訓練，以及資訊軟硬體設備的分級權限管控措施，亦大幅降低機密資料外洩風險，並結合強大的專利智財能量與智財獎勵制度執行，充分對外展現創新技術實力，也將有助於獲取金融機構及投資人信賴，增加資金調度、融資或增資之可能性及金額，於未來開拓更寬廣的市場發展機會。

有利爭取 外界投資 或補助



提升企業 形象 / 價值



透過智慧財產報告書展現公司的創新研發能量，提升企業技術領先的形象及市場競爭力

藉由智慧財產報告書對外展現閱康科技基於智慧財產所創造的獨特性、市場優勢與創新能量，可強化公司的技術領先形象。而逐年快速累積成長的優質專利智財數量，也是公司實質的創新技術資產，其對於現在或未來的市場競爭力提升，將有相當大的效益。

閱康科技成立 20 年來，除了提供優質快速的專業檢測服務外，並持續投資先進分析設備，目前已然成為國際科技業的研發服務中心及貴儀中心，所服務的客戶除國內各類產業領導廠商外，更提供材料分析技術服務給歐、美、日等先進開發地區，客戶群涵蓋半導體廠、汽車廠、學術研究單位及設備製造商。由於客戶多半是知名國際大廠，檢測分析需求大部份是研發中的先進產品或技術，其通常具有相當高的技術挑戰，因此公司的創新研發能量，絕對是其選擇分析檢測合作對象的關注焦點之一。閱康科技在目前擁有的高品質技術專利基礎上，逐年加大研發投資、累積強大的創新動能，此形成的企業技術領先形象與智財應用價值，對於穩固閱康科技與業務往來夥伴、客戶間之合作關係，將有極大的幫助。

5 · 與智慧財產相關之風險應對措施

公司具備完善之智財爭議處理機制

閱康科技目前並無任何智財糾紛，但已建立起完善之智財爭議處理機制，如遭遇智財爭議案件，即可依照公司內部制度規範採取適當之因應措施，詳細處理流程如圖 4-9 所示。

避免侵害他人智慧財產權之風險控管機制

(1) 智慧財產相關檢索：

閱康科技於研發前會先進行提案審查程序，對於有疑慮之案件會委由外部顧問或代理人進行檢索等相關評估作業，亦會根據評估結果，針對研發內容進行迴避設計，避免研發之內容侵害他人的智慧財產權。

(2) 合約之風險控管：

閱康科技於採購時要求廠商簽屬的採購契約中皆有納入不侵權承諾及智慧財產權歸屬之約定，降低來自外部的智財風險疑慮。

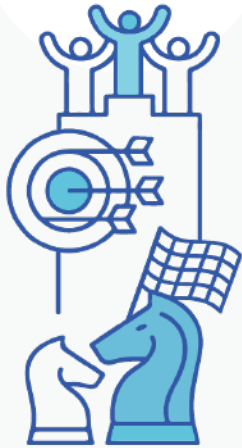
(3) 避免員工侵害他人智慧財產之因應措施：

閱康科技對於新進人員，會於其入職時進行先前工作所涉智財狀況之調查；定期針對員工進行教育訓練，強化員工智財基礎與管理認知，避免因資訊不足或知識不足而侵害他人的智慧財產權。

避免他人侵害公司智慧財產權之風險控管機制

閱康科技已建立起完善的智財爭議處理機制，若發現本公司的智慧財產權有遭他人侵害之疑慮，將通知管理單位，管理單位於接獲通知後即會進行或委託外部顧問或代理人進行智慧財產侵權風險分析，詳細處理流程如上述圖 4-10。

築高業界競爭門檻



導入 TIPS A 級管理制度保護公司研發資源，強化技術領先優勢，拉開競業距離

閱康科技是「首家成功導入 TIPS A 級管理制度的國內分析檢測企業」，同時也是獲准專利數量最多、技術創新能力最高的公司。透過 TIPS 智財管理制度的實施，可擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，建立一套藉由智慧財產權來創造公司價值的運作模式，不僅保護公司營運自由、維持創新能量，另一方面亦可強化競爭優勢，並可援引用來幫助企業獲利，達成營運目標。

保護客戶機密是分析檢測產業者最基本、也是最重要的執業要求。基於 TIPS 智財管理制度的規範，閱康科技平日落實執行對於員工的智財及保密相關教育訓練，以及資訊設備與文件的機密分級權限管控措施，此可大幅降低機密資料外洩風險。同時，在智財產出的標準程序上，由於任何研發項目都會有嚴謹的專利檢索及提案審查，除了可避免將大量研發資源投入開發有侵權疑慮的產品外，更能夠藉此產出高價值的專利技術，在檢測事業領域中發揮競爭優勢。此外，閱康科技藉由智財揭露及揭露制度的導入實施，使客戶得以更加認識公司強大的智財能量，將有助於強化企業創新專業的形象，吸引更多訂單或投資，並於市場上架構更高的競爭門檻，維持公司本身在市場上的領先優勢及技術競爭力。

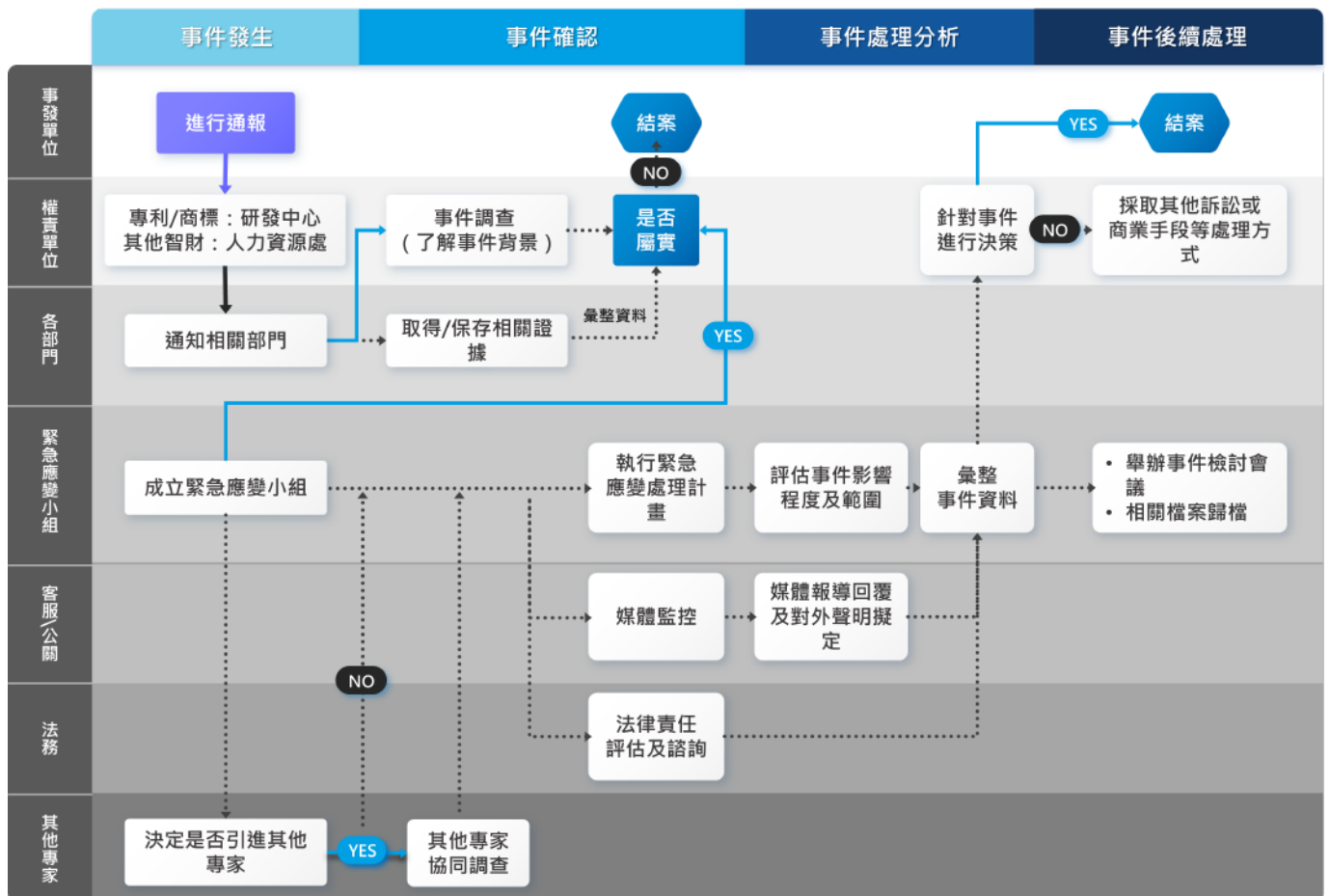


圖 4-9：爭議事件處理流程

預防公司營業秘密及客戶機密資訊外洩之風險控管機制

(1) 實施機密資訊管理制度：

自2023年6月起，公司在外部知名律師事務所的輔導下，完成了「機密資訊管理制度」的建置。為確保制度的有效推行，公司已正式頒布機密資訊管理規範，並成立專責的機密資訊管理組織。自2024年5月1日起，該組織被授權全面負責管理、執行與落實機密資訊管理制度的各項程序，確保公司的重要資訊，包括商業經營策略與技術創新成果，均能獲得妥善保護。此舉將協助公司進一步保障研發成果與競爭力，並降低因營業秘密外洩而導致的經營風險。

(2) 內部人員管制：

針對公司員工有要求簽訂相關保密協議，針對洩密進行管制，亦針對資料之存取進行嚴格控管，避免資料外洩；於員工離職時會對離職員工進行面談，針對移交相關規定與保密義務進行嚴格要求，同時清點該離職員工於任職期間接觸之所有檔案、紀錄、設備，防止因人員異動導致公司營業秘密及客戶機密資訊外洩。

(3) 外部廠商之限制：

閱康科技內部規劃有管制區域，外部廠商到訪時皆有嚴格的管制措施；於研發管理或智慧財產管理委外時，要求合作廠商簽署的契約皆有保密約定，極力避免公司內部資訊外流。

(4) 營業秘密教育訓練及內部稽核：

定期針對員工進行教育訓練，強化員工對於保密義務之認知；每年皆會安排內部稽核，確保相關保密措施皆有嚴格執行，落實資訊防護，避免公司營業秘密及客戶機密資訊外洩。

(5) 資訊安全控管：

閱康科技已建置完善且嚴謹的資訊安全通報與處理機制 (如圖 4-10 所示)。此外，公司亦以系統化方法量化評估資訊資產可能面臨之風險，包括資產價值認定、弱點程度及威脅程度等面向，並由「資訊安全管理推動小組」負責審核與控管，確保資訊安全制度得以確實落實。

閱康科技更通過「ISO27001 (資訊安全)」、「ISO15408 (IT Security Evaluation)」、「台灣智慧財產管理制度 TIPS A 級驗證」等多項專業管理系統驗證，且經經貿公會廠內驗證的現場稽核，並定期接受外部稽核認證機構之審核，將客戶資訊存取於獨立伺服器、獨立網路環境，以避免資訊混淆或人員資訊誤寄。

閱康科技專門提供客戶檢測服務，涉及資訊皆為客戶產品之機密，對此，公司以最嚴格之保密措施、最嚴謹之資訊安全控管，確保客戶機密資訊無外洩之疑慮，且閱康科技過往亦無任何機密資訊外洩之案例，深獲客戶信賴，因此長期委託閱康科技提供技術服務。



圖 4-10：資訊安全事件與通報機制



智慧財產管理不僅事關保護公司技術、維持公司的競爭力，
更是攸關客戶資料之保全，以確保公司的信用。

閱康科技導入ISO 相關規定及台灣智慧財產管理制度 (TIPS)，
藉由針對資訊、設備以及內外部人員進行嚴格控管，
防止公司技術資訊外流，並確保客戶機密資訊無外洩之疑慮，
確實保護公司研發之智慧財產、維繫客戶信賴。

The Best R&D Partner

關注更多閱康科技

